

平成 26 年 5 月 20 日

お客様各位

東京エレクトロデバイス株式会社
設計開発センター 品質管理部
部長 千野 修

後工程 製造拠点の変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在貴社にてご採用頂いております下記製品につきまして、後工程の製造拠点変更がございます。

下記の通り報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

- 記 -

1. 対象型格：TE7783APF、TE8201PF

2. 変更内容：後工程製造拠点変更(組立・測定変更)

【変更前】関東三洋セミコンダクターズ株式会社 羽生工場

【変更後】ON Semiconductor SSMP Philippines Corporation

旧社名;三洋半導体製造フィリピン株式会社(略称;SSMP)

3. 変更理由：オン・セミコンダクターの継続的なグローバル生産体制改善の取り組みとして、三洋半導体株式会社の関係会社である関東三洋セミコンダクターズ株式会社(羽生工場)の2014年6月末までの閉鎖に向けたオペレーション開始しによる製造工場の変更。

4. 製造拠点変更に伴う変化点：今回の後工程製造拠点の変更に伴う4M変化点について、設備及び作業者は変更となりますが、パッケージ寸法・材料、工程管理、信頼性、電気的特性、実装保証条件などの製品仕様に変更はございません。

4M 変更点検証：

工程名(フロー)	使用装置		使用材料		変化点	変更内容説明
	移管前：KSS(日本)	移管後：SSMP(フィリピン)	移管前：KSS(日本)	移管後：SSMP(フィリピン)		
ダイシング	フルオートダイシングソー	移管先の同型設備	純水	同じ管理基準	無	同型装置及び同じ管理基準となります
ダイボンディング	フルオートダイボンダ	移管先の同型設備	リードフレーム Agペースト	同じ	無	同型装置及び同じ材料を使用します
ワイヤボンディング	フルオートワイヤボンダ	移管先の同型設備	金線	同じ	無	同型装置及び同じ材料を使用します
モールディング	トランスファモールド装置	移管先の同型設備	エポキシ系樹脂	同じ	無	同型装置及び同仕様の金型、同じ材料を使用します
マーキング	レーザ印刷機	移管元の設備移設	-	-	無	同一装置及び印字形式を使用します
メッキ	外注メッキ	SSMP社内	Sn-Biメッキ	同じ	無	社内及び外注先のメッキ仕様及び設備仕様、処理条件は弊社指定の同一条件です
切断曲げ	リード加工機	移管先の同型設備	-	-	無	同型装置及び同仕様の金型を使用します
電氣的測定検査	測定テストフルオートハンドラ	移管先の同型設備	-	-	無	同型装置及び同一プログラムを使用します
最終外観検査	KSS認定合格検査員	SSMP認定合格検査員	-	-	無	移管前後とも、同一の認定制度にて運用します

5. 信頼性試験データ：添付資料をご参照頂けますようお願いいたします。

信頼性評価結果に問題ございません。

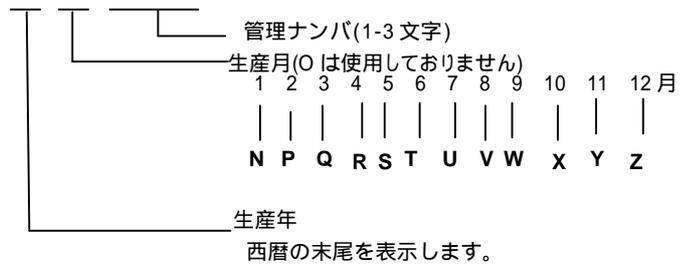
6. 移管時期：2014年6月以降移管予定

弊社からの出荷時期については、在庫状況によりますので別途ご連絡させていただきます。

7. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。

具体的には、以下のとおりロットナンバーの生産月が海外製品はN-Zとなります。

ロットナンバー



以上

平成 26 年 5 月 16 日

お客様各位

東京エレクトロニクス株式会社
設計開発センター 品質管理部
部長 千野 修

後工程 製造拠点の変更について

拝啓、貴社益々ご清栄の段お慶び申し上げます。

又、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、現在貴社にてご採用頂いております下記製品につきまして、後工程の製造拠点変更がございます。

下記の通り報告しますので、宜しくお願い申し上げます。

内容につきましてご確認の上、返信用紙にご捺印を頂き、お手数ですがご返信頂きたく存じます。

敬具

- 記 -

- 対象型格：TE7783APF、TE8201PF
- 変更内容：後工程製造ライン変更(組立・測定変更)
【変更前】関東三洋セミコンダクターズ株式会社 羽生工場
【変更後】ON Semiconductor SSMP Philippines Corporation
旧社名;三洋半導体製造フィリピン株式会社(略称;SSMP)
- 変更理由：オン・セミコンダクターの継続的なグローバル生産体制改善の取り組みとして、三洋半導体株式会社の関係会社である関東三洋セミコンダクターズ株式会社(羽生工場)の2014年6月末までの閉鎖に向けたオペレーション開始しによる製造工場の変更。
- 製造拠点変更に伴う変化点：今回の後工程製造拠点の変更に伴う4M変化点について、設備及び作業者は変更となりますが、パッケージ寸法・材料、工程管理、信頼性、電気的特性、実装保証条件などの製品仕様に変更はございません。

4M 変更点検証:

工程名(フロー)	使用装置		使用材料		変化点	変更内容説明
	移管前: KSS (日本)	移管後: SSMP (フィリピン)	移管前: KSS (日本)	移管後: SSMP (フィリピン)		
ダイシング	フルオート ダイシングソー	移管先の同型 設備	純水	同じ管理基準	無	同型装置及び同じ管理基準となります
ダイボンディング	フルオート ダイボンダ	移管先の同型 設備	リードフレーム Agペースト	同じ	無	同型装置及び同じ材料を使用します
ワイヤ ボンディング	フルオート ワイヤボンダ	移管先の同型 設備	金線	同じ	無	同型装置及び同じ材料を使用します
モールディング	トランスファ モールド装置	移管先の同型 設備	エポキシ系樹脂	同じ	無	同型装置及び同仕様の金型、同じ材料を使用します
マーキング	レーザ印刷機	移管元の設備 移設	-	-	無	同一装置及び印字形式を使用します
メッキ	外注メッキ	SSMP社内	Sn-Biメッキ	同じ	無	社内及び外注先のメッキ仕様及び設備仕様、処理条件は弊社指定の同一条件です
切断曲げ	リード加工機	移管先の同型 設備	-	-	無	同型装置及び同仕様の金型を使用します
電氣的測定検査	測定テスト フルオートハンドラ	移管先の同型 設備	-	-	無	同型装置及び同一プログラムを使用します
最終外観検査	KSS 認定 合格検査員	SSMP 認定 合格検査員	-	-	無	移管前後とも、同一の認定制度にて運用します

5. 信頼性試験データ：添付資料をご参照頂けますようお願いいたします。

信頼性評価結果に問題ございません。

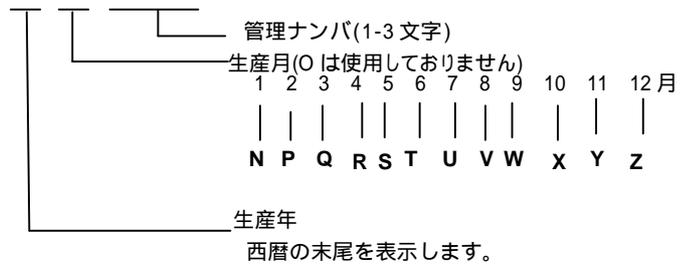
6. 移管時期：2014年6月以降移管予定

弊社からの出荷時期については、在庫状況によりますので別途ご連絡させていただきます。

7. 識別方法：ロットナンバーにて識別可能です。

具体的には、以下のとおりロットナンバーの生産月が海外製品はN-Zとなります。

ロットナンバー



以上

貴社受領印欄	
日付：	_____
貴社名：	_____
部署名：	_____
ご署名：	_____ 印

東京エレクトロンデバイス株式会社
設計開発センター 品質管理部